

Płyty styropianowe GOLD fundament

Opis

Płyty styropianowe GOLD fundament oznaczane są poniższym kodem wg normy

PN-EN 13163:2004/AC:2006

EPS EN 13163

T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3

Są to płyty styropianowe uszlachetnione kompozycją związków hydrofobowych, które poprawiają właściwości izolacyjne i zwiększają odporność na działanie wody w całej objętości. Produkowane są na bazie innowacyjnego surowca PERIPOR firmy BASF. Płyty styropianowe GOLD fundament mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrób jest w bezpośrednim kontakcie z wodą przez długi okres czasu w połączeniu ze zmianą temperatury. Płyty mogą mieć również bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Płyty styropianowe GOLD fundament nadają się do stosowania w miejscach, w których obciążenia nie przekraczają 40 kPa (4000 kg/m²).

Zastosowanie

- izolacja cieplna ścian zagłębionych w gruncie
- izolacja cieplna ścian piwnic i fundamentów
- izolacja miejsc mocno zawilgoconych, gdzie materiał izolacyjny musi być odporny na działanie wody

Wykonanie

Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojącą i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych, warstwą izolacji wodochronnej lub ziemią w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty GOLD fundament, mają podwyższoną odporność na działanie promieniowania UV, jednak w przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne

wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takim przypadku przed wykonaniem warstwy zbrojącej w systemach ociepleń metodą lekką-mokrą warstwę tę należy usunąć za pomocą drobnego papieru ściernego, tak, żeby nie było na powierzchni płyt luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.

Do przyklejania płyt styropianowych GOLD fundament stosować klej poliuretanowy do styropianu Platinum SP-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi, z wyjątkiem warstw znajdujących się w gruncie) lub klej do styropianu Platinum SP-KS. Do wykonywania warstwy zbrojącej stosować klej uniwersalny Platinum SP-KU oraz siatkę Platinum SP-S145 lub SP-S170.

Uwaga

Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

Pakowanie, przechowywanie, transport

Płyty styropianowe GOLD fundament są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2004, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

Płyty styropianowe GOLD fundament należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Dokumentacja techniczna

- PN-EN 13163:2004/AC:2006
- Rekomendacje Techniczne i Jakości Instytutu Techniki Budowlanej RTQ ITB-1059/2006
- Certyfikat zgodności ITB-851/W
- Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0871/02/2006

Deklarowane właściwości płyt styropianowych GOLD fundament

Właściwości	Deklarowana klasa lub poziom
Klasy tolerancji wymiarów: <ul style="list-style-type: none"> • grubość • długość • szerokość • prostokątność • płaskość 	T1 (± 1 mm) L1 (± 3 mm lub ± 0,6%*) W1 (± 3 mm lub ± 0,6%*) S1 (± 5 mm / 1000 mm) P3 (10 mm)
Poziom wytrzymałości na zginanie	BS250 (≥ 250 kPa)
Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym	CS(10)200 (≥ 200 kPa)
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych	DS(N)5 (± 0,5 %)
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)	DS(70,-)2 (≤ 2 %)
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	DLT(1)5 (≤ 5 %)
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu	WL(T)3 (≤ 3 %)
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D , w temp. 10°C	≤ 0,033 W/(m·K)
Współczynnik przewodzenia ciepła z RTQ ITB λ_{RTQ}^{**}	0,031 W/(m·K)
Klasa reakcji na ogień	E

*) wartość, która daje większą tolerancję

**) λ_{RTQ} - średni współczynnik przewodzenia ciepła, uzyskiwany w Laboratoriach firmy Termo Organika w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (w średniej temp. 10°C, warunkach suchych, na próbkach grubości 50 mm)

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D , w zależności od grubości płyt GOLD fundament

Grubość, mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200
$R_D, m^2K/W$	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	4,50	4,80	5,15	5,45	6,05

Ilość płyt w paczce, objętość paczek i powierzchnia w opakowaniu dla poszczególnych grubości płyt. Standardowy wymiar płyt GOLD fundament: 1000 mm x 500 mm

Grubość, mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200
Ilość płyt w paczce (szt.)	60	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3
Płyty gładkie																			
Objętość paczki (m ³)	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,280	0,280	0,270	0,300	0,275	0,30	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270	0,300
Powierzchnia płyt w paczce (m ²)	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Płyty frezowane																			
Objętość paczki (m ³)				0,284	0,284	0,284	0,265	0,265	0,256	0,284	0,260	0,284	0,246	0,265	0,284	0,227	0,241	0,256	0,284
Powierzchnia płyt w paczce (m ²)				7,10	5,68	4,73	3,79	3,31	2,84	2,84	2,37	2,37	1,89	1,89	1,89	1,42	1,42	1,42	1,42

Biura handlowe: Mielec: tel.: 17 773 91 57, fax: 17 773 91 51
 Głogów: tel.: 76 835 71 20, fax: 76 835 71 40
 Siedlce: tel.: 25 631 02 07, fax: 25 631 02 09
 e-mail: styropian@termoorganika.com.pl

Termo Organika Sp. z o.o.
 ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków
 tel.: 12 427 07 40, fax: 12 427 27 21, www.termoorganika.com.pl, e-mail: systemplatinum@termoorganika.com.pl